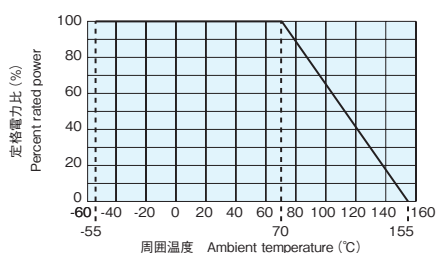




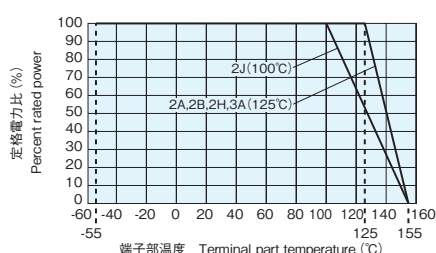
## ■ 負荷軽減曲線 Derating Curve

周囲温度 Ambient temperature

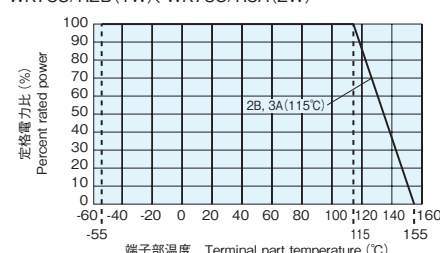


周囲温度70℃以上で使用される場合は、上図負荷軽減曲線に従って、定格電力を軽減して御使用ください。  
For resistors operated at an ambient temperature of 70°C or above, a power rating shall be derated in accordance with the derating curve.

端子部温度 Terminal part temperature



端子部温度 Terminal part temperature  
WK73S/R2B (1W), WK73S/R3A (2W)



- 上記の端子部温度以上で使用される場合は、負荷軽減曲線に従って定格電力を軽減してご使用ください。
- ご使用方法につきましては巻頭の“端子部温度の負荷軽減曲線の紹介”を参照願います。
- For resistors operated terminal part temperature of described for each size or above, a power rating shall be derated in accordance with derating curve.
- Please refer to “Introduction of the derating curves based on the terminal part temperature” on the beginning of our catalog before use.

## ■ 性能 Performance

試験項目 Test Items	規格値 Performance Requirements $\Delta R \pm (\% + 0.005\Omega)$		試験方法 Test Methods
	保証値 Limit	代表値 Typical	
抵抗値 Resistance	規定の許容差内 Within specified tolerance	—	25°C
抵抗温度係数 T.C.R.	規定値内 Within specified T.C.R.	—	+25°C / -55°C and +25°C / +125°C
過負荷 (短時間) Overload (Short time)	2	0.2	定格電圧×2.5倍を5秒印加 Rated voltage×2.5 for 5s (WK73S/R2A (0.75W, 1W), WK73S/R2B (1W), WK73S/R3A (2W)) 定格電圧×2.0倍を5秒印加 Rated voltage×2.0 for 5s
はんだ耐熱性 Resistance to soldering heat	1	0.2	260°C±5°C, 10s±1s
端子強度 Bending test	1	0.1	たわみ強さ：支持点間隔90mm、たわみ回数1回、曲げ5mm Holding point 90mm, Bending 1time, Bending 5mm
温度急変 Rapid change of temperature	0.5	0.3	-55°C (30min.) / +125°C (30min.) 100 cycles
耐湿負荷 Moisture resistance	2	0.2	40°C±2°C, 90%~95%RH, 1000h 1.5時間 ON / 0.5時間 OFFの周期 1.5h ON / 0.5h OFF cycle
70°Cでの耐久性 Endurance at 70°C	2	0.2	70°C±2°C, 1000h 1.5時間 ON / 0.5時間 OFFの周期 1.5h ON / 0.5h OFF cycle
高温放置 High temperature exposure	1	0.2	+155°C, 1000h
耐硫化性 Sulfuration test	5	0.2	硫黄成分3.5%含有工業用油浸漬105°C±3°C 500h Soaked in industrial oil with sulfur substance 3.5% contained 105°C ±3°C 500h

## ■ 使用上の注意 Precautions for Use

- チップ抵抗器の基材はアルミナです。実装する基板との熱膨張係数の違いから、ヒートサイクル等の熱ストレスを繰り返し与えた場合、接合部のはんだ (はんだフィレット部) にクラックが発生する場合があります。WK73シリーズは自己発熱も大きいことより、周囲温度の変動が大きく繰り返される場合や、負荷のオンオフが繰り返される場合は、クラックの発生に注意が必要です。熱ストレスによるクラックの発生は、実装されるランドの大きさ、はんだ量、実装基板の放熱性等に左右されますので、周囲温度の大きな変化や負荷のオンオフのような使用条件が想定される場合は、十分注意して設計してください。
- The substrate of chip resistors is alumina. Cracks may occur at the connection of solder (solder fillet portion) due to the difference of the coefficient of thermal expansion from a mounting board when heat stress like heat cycle, etc. are repeatedly given to them. Care should be taken to the occurrence of the cracks when the change in ambient temperature or ON/OFF of load is repeated, especially when WK73 series which have self-heating. The occurrence of the crack by heat stress may be influenced by the size of a pad, solder volume, heat radiation of mounting board etc., so please pay careful attention to designing when a big change in ambient temperature and conditions for use like ON/OFF of load can be assumed.